

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料の価格改定について

住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、社長：藤原一彦）は、半導体封止用エポキシ樹脂成形材料（以下、スミコン® EME）の価格改定を行うこととしましたのでお知らせ致します。

当社は、2020年秋以来のスミコン® EME 製品の旺盛な需要にお応えすべく、生産能力増強を進め、将来に向けての供給体制構築と早期実績化を目指しております。

一方主要原料においては、2017年より中国政府による環境規制強化の影響を受けサプライチェーンでの需給バランスが逼迫し、価格高騰している状態が続いております。これに加えコンテナ不足による輸送賃の値上げや、航空運賃の値上げなど物流費用の高騰にも直面しております。これまで当社としましては、自助努力による生産コスト削減で価格を維持して参りましたが、ここに来て自助努力によるコスト吸収は困難となっております。

つきましては、下記内容の価格改定を顧客に申し入れることと致しました。

- | | | |
|--------|----------------|--------|
| 1、改定内容 | スミコン® EME 製品 | 10～20% |
| 2、実施時期 | 2021年3月 納入分より。 | |

この製品についてのお問合せ先：

住友ベークライト株式会社 情報通信材料営業本部

Tel：03-5462-4264

お問い合わせフォーム：https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j_itmaterials_epoxy

このリリースに関するお問い合わせは
コーポレートコミュニケーション部
広報担当まで

〒140-0002
東京都品川区東品川2丁目5-8
天王洲パークサイドビル

TEL (03) 5462-4818
FAX (03) 5462-4873
WEBSITE <https://www.sumibe.co.jp>